# 技术创新需求调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业信息** | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | 昆山双桥传感器测控技术有限公司 | | | | 机构代码 | | 91320583726630888Y | |
| 区 域 | | 昆山周庄 | | 联系人 | 戴敏 | | 电话 | | 0512-57218453 |
| 行业领域 | | 电子信息 | | | | 产业领域 | | 仪器仪表制造 | |
| 经济规模 | | 年销售1千万以上 | | | | 人员规模 | | 50人 | |
| **需求信息** | | | | | | | | | |
| 需求名称 | | | 硅谐振压力传感器技术 | | | | | | |
| 技术需求情况说明 | 技术需  求类别 | | 技术研发（关键、核心技术）  产品研发（产品升级、新产品研发）  □技术改造（设备、研发生产条件）  □技术配套（技术、产品等配套合作） | | | | | | |
| 技术  需求  简述 | | 开展性价比高、技术基于MEMS技术或与之兼容的小体积，小尺寸，易集成的高度测量或真空度测量高精度传感器有很大市场需求及拓展能力。 | | | | | | |
|  | 技术  需求  详述 | | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）  基于MEMS技术的硅谐振式压力传感器的设计技术、微封装技术、基于谐振原理的真空度传感器集成制造技术，传感器的小型化轻型化封装技术，万分之一量级精度的保障技术、温补技术、样品生产级的成熟度或联合达到此成熟度。 | | | | | | |
| 现有  基础  情况 | | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等）  企业现有千分之一精度级真空度－高度传感器的开发与试用基础，有条件MEMS硅压力传感器设计制造技术基础。 | | | | | | |
| 产学研合作要求 | 简要  描述 | | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）  MEMS技术、传感器技术、测量与控制技术、精密仪器技术领先的重点高等院校或国家重点实验室。 | | | | | | |
| 合作  方式 | | 技术转让 技术入股 联合开发 □委托研发  □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 | | | | | | |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融  □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购  □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 | | | | | | | | |
| **管理信息** | | | | | | | | | |
| 同意公开  需求信息 | | ☑是 □否  □部分公开(说明） | | | | | | | |
| 同意接受  专家服务 | | ☑是  □否 | | | | | | | |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 | | ☑是  □否 | | | | | | | |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 | | □是，金额 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）  □否  法人代表：王文襄 2018 年8月7日 | | | | | | | |

**※请务必确认“同意公开需求信息”一栏填“是”**